



2013年3月期

中間決算説明会

(第2四半期累計)

2012年11月22日

 **ワイエイシー株式会社**

(証券コード:6298)

<http://www.yac.co.jp>

Contents

1. ご挨拶、決算のポイント

…………… 代表取締役 社長 百瀬 武文

2. 2013年3月期第2四半期連結決算の概要

…………… 管理本部 経理部長 古橋 博

3. 2013年3月期連結決算の見通し

…………… 代表取締役 社長 百瀬 武文

4. 質疑応答



1. ご挨拶、決算のポイント

..... 代表取締役 社長 百瀬 武文

1 決算のポイント



- **前年同期比 増収・増益。**
収益面は伸び悩んだ。
- **受注の伸び悩み。**
全般的な設備投資見直しの影響。
- **スマホ・タブレット向け装置の需要は引き続き堅調。**



2. 2013年3月期第2四半期 連結決算の概要

..... 管理本部 経理部長 古橋 博

2-1 事業結果



(単位:百万円)

	2012年3月期 第2四半期 連結累計期間	2013年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
売上高	6,584	10,919	4,334	65.8%
営業利益 (営業利益率)	181 (2.8%)	357 (3.3%)	175	96.3%
経常利益	162	292	129	79.5%
当期純利益	308	195	▲113	▲36.7%
1株当たり 当期純利益(円)	33.41	21.91	▲11.50	—
研究開発費	109	140	30	28.0%
設備投資額	17	50	33	190.3%
減価償却実施額	127	132	4	3.2%

2-2 事業別売上金額



(単位:百万円)

	2012年3月期 第2四半期 連結累計期間	2013年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
メモリーディスク関連	1,291	1,936	645	50.0%
フラットパネル関連	1,868	6,746	4,877	261.1%
半導体関連	370	201	▲168	▲45.5%
太陽電池関連	792	507	▲285	▲36.0%
FEL関連	10	0	▲9	▲90.5%
精密熱処理関連 (ワイエイシイデンコー)	1,728	1,003	▲725	▲42.0%
クリーニング関連	523	523	0	—
合計	6,584	10,919	4,334	65.8%

2-3 事業別受注金額



(単位:百万円)

	2012年3月期 第2四半期 連結累計期間	2013年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
メモリーディスク関連	1,178	902	▲276	▲23.5%
フラットパネル関連	7,090	4,005	▲3,084	▲43.5%
半導体関連	322	250	▲71	▲22.1%
太陽電池関連	330	423	92	28.0%
FEL関連	10	0	▲9	▲90.4%
精密熱処理関連 (ワイエイシイデンコー)	1,700	968	▲731	▲43.0%
クリーニング関連	523	523	0	—
合計	11,155	7,074	▲4,080	▲36.6%

* クリーニング関連は販売計画に基づいた見込み生産のため受注=売上となります。

2-4 事業別受注残高



(単位:百万円)

	2012年3月期 第2四半期 連結累計期間	2013年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
メモリーディスク関連	327	250	▲76	▲23.3%
フラットパネル関連	6,983	3,483	▲3,499	▲50.1%
半導体関連	90	64	▲26	▲29.2%
太陽電池関連	244	393	148	60.5%
FEL関連	0	0	0	—
精密熱処理関連 (ワイエイシイデンコー)	1,852	1,018	▲833	▲45.0%
クリーニング関連	0	0	0	—
合計	9,498	5,210	▲4,287	▲45.1%

2-5 貸借対照表のレビュー

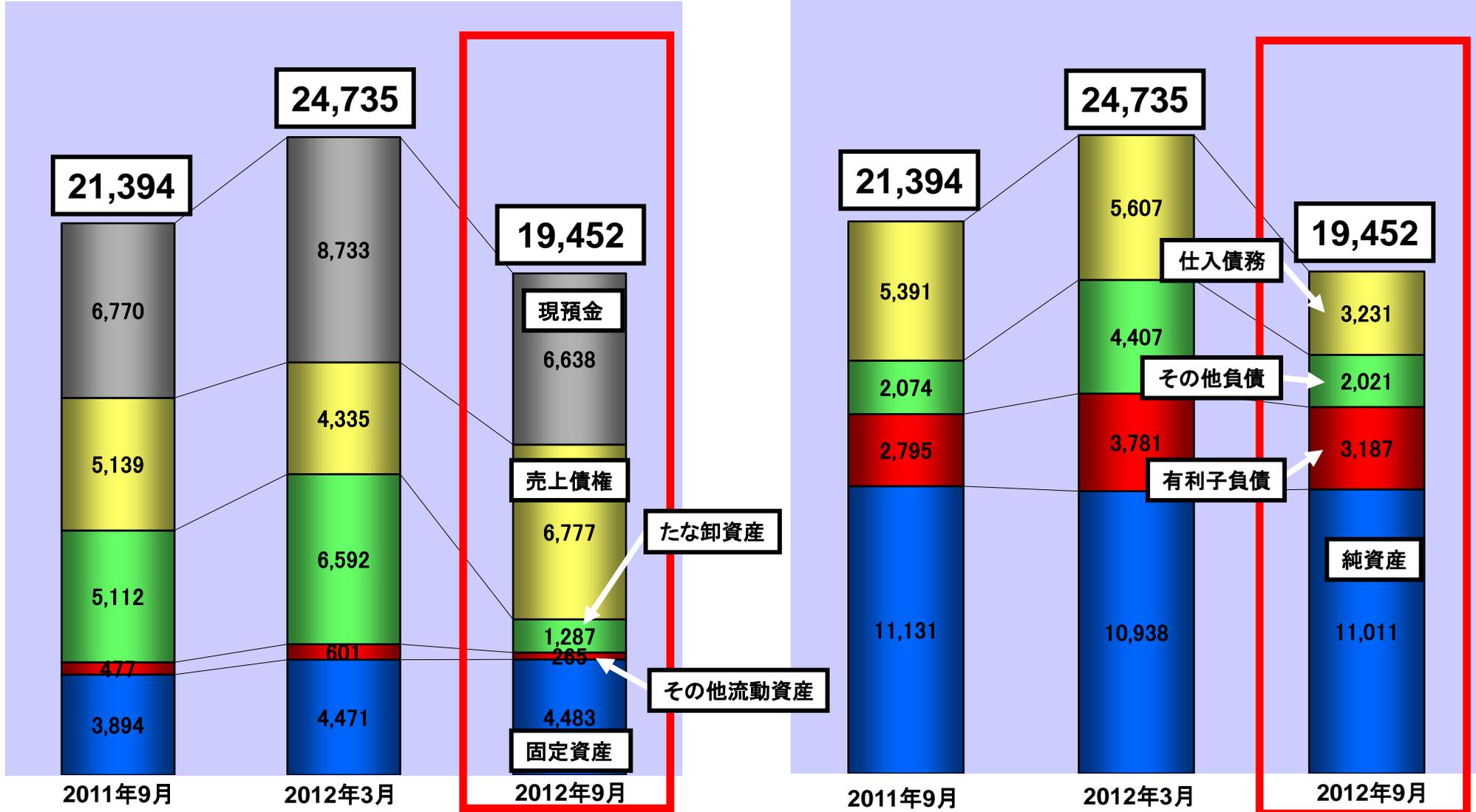


資産

(単位:百万円)

負債・純資産

(単位:百万円)



2-6 キャッシュフローのレビュー



(単位:百万円)

	2011年3月期 第2四半期 連結累計期間	2012年3月期 第2四半期 連結累計期間	2013年3月期 第2四半期 連結累計期間
営業活動によるCF	2,103	467	▲1,125
投資活動によるCF	▲13	462	▲65
財務活動によるCF	▲429	▲728	▲876
現金及び現金同等物の 期末残高	6,834	6,675	6,540



3. 2013年3月期連結決算の見通し

..... 代表取締役 社長 百瀬 武文

《ハードディスク関連》

- PC需要の伸び率低下に伴う設備投資の先送り
- レーザースクライブ(スマホ、タブレット用ガラスの切断)の販売開始
- 搬送技術の応用 : 検体搬送(医療関連)、電池関連へ参入

《フラットパネル関連》

- スマホ、タブレット、有機EL市場の拡大
- 上記市場向け装置のシェアアップ
高密度ドライエッチング装置、アニール装置
- プラズマ技術を応用し、新規分野へアプローチ

《半導体関連》

- スマホ・タブレット、イメージセンサ、自動車向けは堅調だが、全般的に市場は低調
- パワー半導体市場へ本格的に参入
- テストハウス市場へ横展開

《太陽電池関連》

- 財政支援の打ち切りにより市場が低迷、先行きは高発電効率のパネルが拡大
- 高発電効率用ミニターンキー装置の販売促進
- 精密洗浄技術を新規分野へ投入

《FEL(フィールドエミッションランプ)関連》

- 自動車用ランプ、UVランプの商品化

《精密熱処理関連》

- 部品軽量化が進む自動車業界
- 自動車部品市場へ本格的に参入

《クリーニング関連》

- 製・販のグローバル化 : 米国・韓国・中国・EU
- 新規事業へ参入

■ **厳しい事業環境が続くが、
前年比 増収・増益の見込み。**

■ **収益は伸び悩む。**

◎ **フラットパネル関連で、立上費用等の増加による収益の圧迫。**

◎ **太陽電池、精密熱処理関連の売上減少。**

3-3 2013年3月期連結見通し



(単位:百万円)

	2012年 3月期	2013年 3月期 (見込)	前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
売上高	12,378	17,000	4,622	37.3%
営業利益	181	300	119	65.7%
経常利益	150	250	100	66.7%
当期純利益	343	150	▲193	▲56.3%
1株当たり 当期純利益(円)	37.77	16.82	▲20.95	—

3-4 事業別売上計画



(単位:百万円)

	2012年 3月期	2013年 3月期 (見込)	前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
メモリーディスク関連	2,777	3,700	923	33.2%
フラットパネル関連	3,512	7,700	4,188	119.2%
半導体関連	682	600	▲82	▲12.0%
太陽電池関連	1,140	1,100	▲40	▲3.5%
FEL関連	12	0	▲12	—
精密熱処理関連 (ワイエイシイデンコー)	3,049	2,500	▲549	▲18.0%
クリーニング関連	1,206	1,400	194	16.1%
売上合計	12,378	17,000	4,622	37.3%

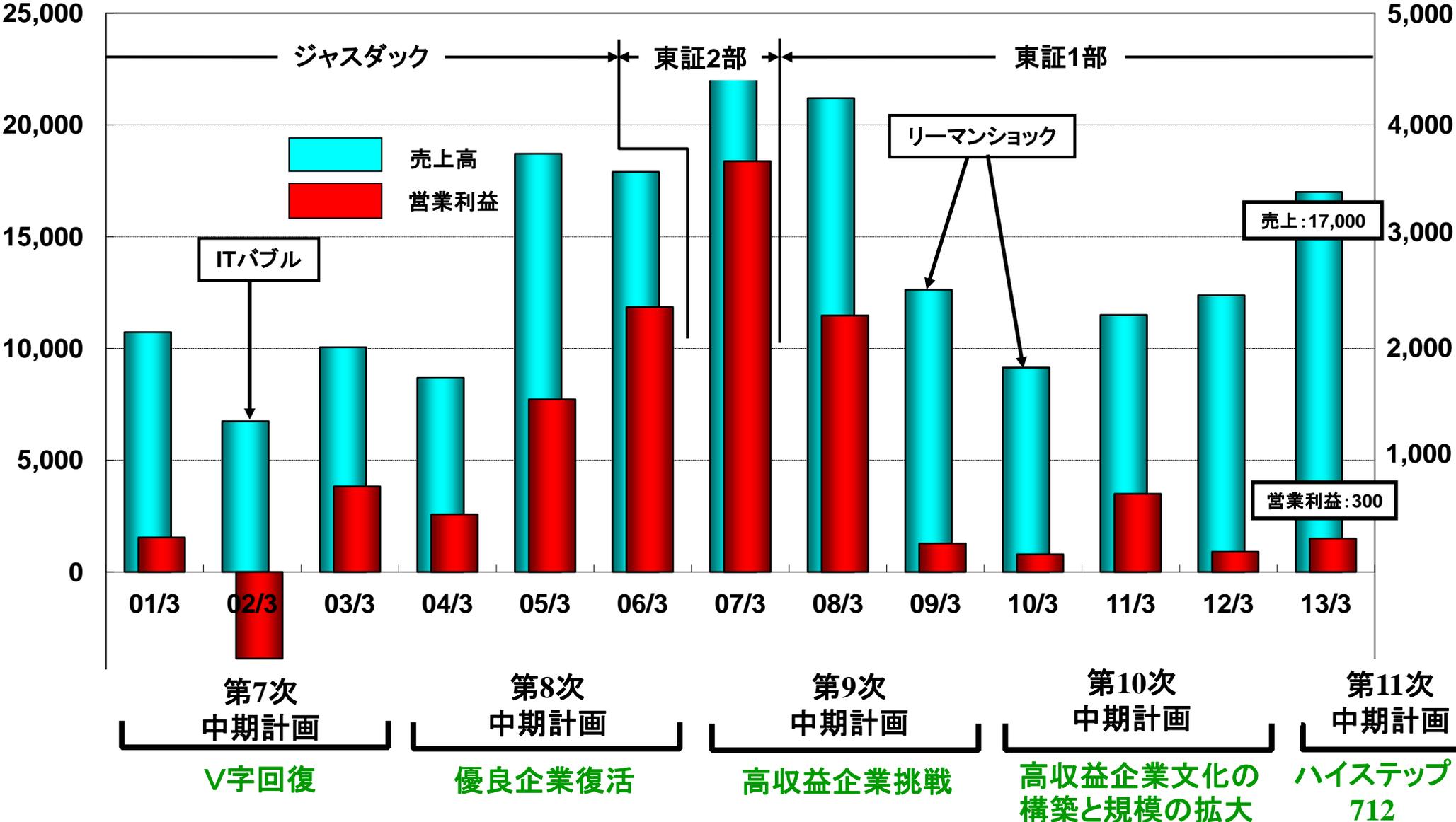
3-5 過去の業績と2013年3月期見込



売上高

(単位:百万円)

営業利益





添付資料 ワイエイシイの概要

1. 基本情報
2. ワイエイシイの特徴
3. グローバルネットワーク
4. ワイエイシイグループの構成
5. 主力製品

1 基本情報



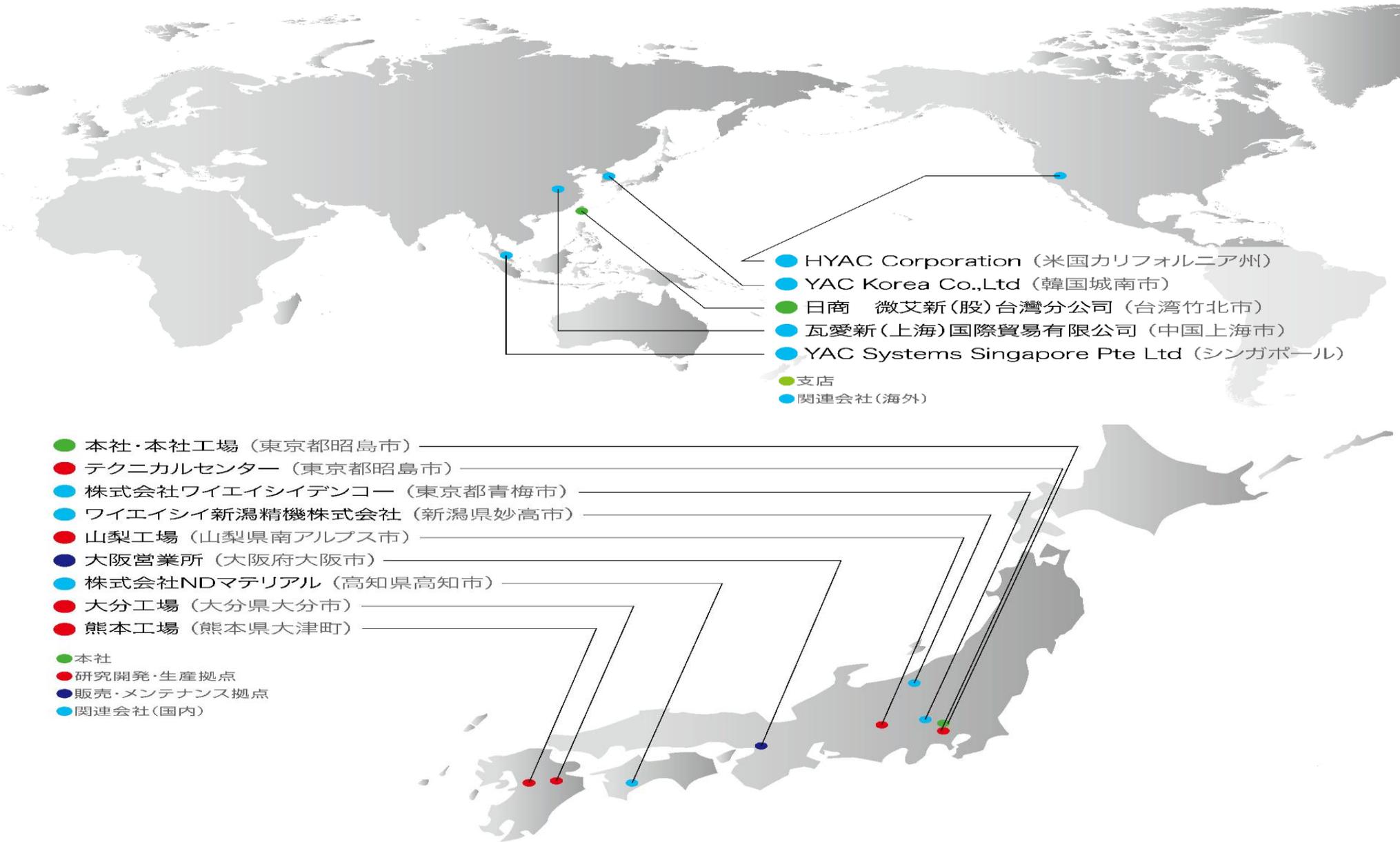
商号	ワイエイシイ株式会社
証券コード	6298 (東証1部)
設立	1973年(昭和48年)年5月
代表者	代表取締役社長 百瀬武文
事業所等	本社：東京都昭島市武蔵野3-11-10 営業所：大阪、昭島、新竹(台湾) 工場：昭島、山梨、熊本、大分
グループ会社	株式会社ワイエイシイデンコー(東京都青梅市) ワイエイシイ新潟精機株式会社(新潟県妙高市) HYAC Corporation(米国カリフォルニア州) YAC Systems Singapore Pte Ltd(シンガポール) YAC KOREA CO.,LTD(韓国城南市) 瓦愛新(上海)国際貿易有限公司(中国上海市)
投資会社	株式会社NDマテリアル
資本金	2,756百万円
事業内容	エレクトロニクス関連装置、クリーニング関連装置の 開発・設計・製造・販売
決算	3月31日

2 ワイエイシイの特徴

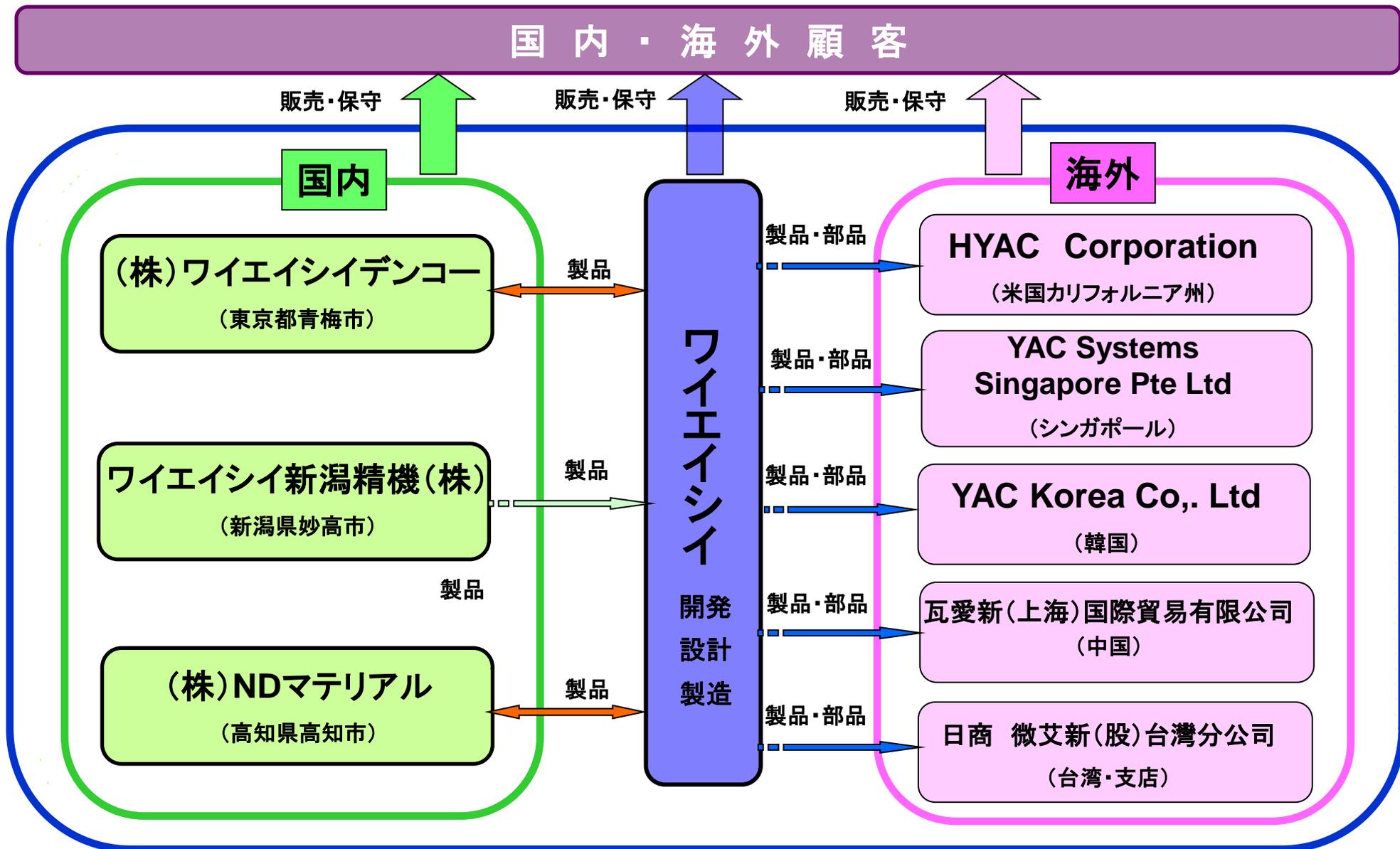


- 7分野の事業領域
- ファブレス
- M&A・アライアンス
- 製・販のグローバル化(アジアに注力)
- デバイス事業への参入
- 社員の経営参画(大討論会)
- 依命システム

3 グローバルネットワーク



4 ワイエイシイグループの構成



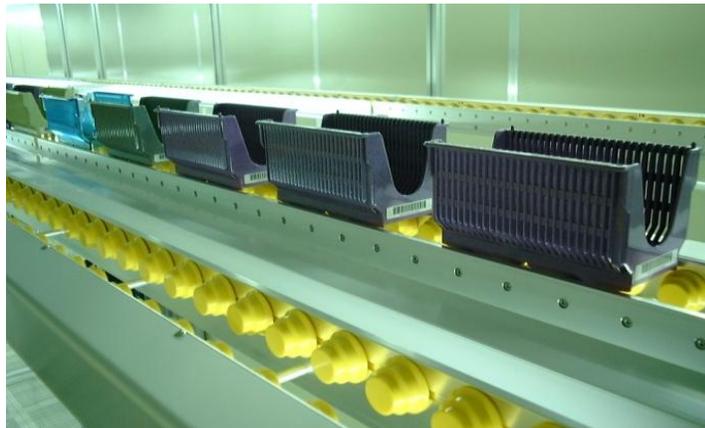
5-1 メモリーディスク事業製品



バニッシャー	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、表面のナノオーダーの微小突起を除去する精密研磨装置
ワイピング	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、バニッシュ工程の前後で、表面のパーティクルの除去及び潤滑財を表面に均一にする装置
UVキュア装置	基盤上の磁性膜面に潤滑剤(紫外線(UV)の波長に適合した潤滑剤が完成)を薄くなじませる装置
クリーンコンベア (HD工場向け)	モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能なローラー式コンベアAGV(自走型搬送ロボット)やOHT(天井架設型搬送装置)に比べ、搬送物をいつでも搬送ラインに投入することができ、搬送効率が高い
クリーンコンベア (半導体工場向け、 太陽電池工場向け)	(同上)但し、半導体向けは搬送物が300mm用ウエハポット、太陽電池はガラス基板又は約5"ウエハーが入ったカセットで、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される
クリーンコンベア (液晶工場向け)	(同上)但し、搬送物はパネルサイズに切りだされた基盤を搬送する、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される



バニッシャー



ハードディスク用クリーンコンベア



半導体用高速クリーンコンベア

5-2 フラットパネル事業製品



プラズマドライエッチング装置

プラズマ技術を用いた、ドライエッチング装置は、LTPS、OLEDといった、スマートフォン向けの高精細加工をはじめとして、製造プロセスの効率化や省マスク技術、大型化などに最適なプラズマエッチング装置

アニール装置

膜質の改質、改善をおこなうための熱処理装置です。YHRシリーズは今後のLTPSスマートフォンをターゲットとした高精細パネル製造に欠かせないRTA装置
LTPS高精細パネルの量産に適した装置性能を保持しており、スマートフォンの更なる高性能化に寄与

バレル式アッシング装置

プラズマ技術を用い半導体向けアッシング工程において国産初のバッチ型アッシング製造プロセス技術装置を提供して以来、表面改質、滅菌分野など広範にわたり対応可能
PACKシリーズは、ポンプと発振器専用ラック内に収納可能な卓上型装置



高密度プラズマドライエッチング装置



アニール装置 (YHRシリーズ)



バレル式アッシング装置
(PACKシリーズ)

5-3 半導体事業製品



ロジック系IC用 テストハンドラー

ICのパッケージ後の検査工程でテスターと接続して使用し、テスターからのテスト結果信号に基づきICを良品と不良品に自動選別する装置
必要に応じて精度の高い低温・高温(-55℃~155℃)下でのテストにも対応可能



C912 : 低・常・高温測定が可能なマルチタイプ、
開発用に最適



A/H343 : 4個同時測定、常・高温タイプ、
低振動、低発塵



A/H543 : 4個同時測定、常・高温タイプの高速型

5-4 太陽電池事業製品



太陽電池(結晶・多結晶) 製造装置

単結晶・多結晶型太陽電池の全ライン(インライン・バッチ方式)の製造装置

特徴

- ・テクスチャリング……………バッチ・インライン装置
- ・拡散炉……………P塗布装置・チューブ(バッチ)式・インライン装置
- ・PSG(ISO)……………バッチ・インライン装置
- ・反射防止膜(AR)成膜……………PECVD装置
- ・配線印刷……………スクリーン印刷/乾燥炉
- ・配線形成(BSF形成)……………焼成炉
- ・その他関連装置



“e-line” : PSG/ISO装置



“e-wet” : テクスチャリング装置

5-5 FEL事業製品



ナノダイヤモンド薄膜製造

金属等の材料の表面に、ナノダイヤモンド膜でコーティングしたエミッターを製作
このエミッターを用いたフィールド・エミッション・ランプ(FEL)を試作

FELの特徴

- ・従来の蛍光灯と異なり、水銀・鉛等の有害物質を使用しない
- ・LED(発光ダイオード)に比べ発熱量が少なく、冷却を必要としない(効率が良い)
- ・長寿命である
- ・色選択の自由度が高い(白色から紫外領域まで)



試作品



試作品



発光写真

5-6 精密熱処理関連製品(ワイエイシイデンコー)

<p>フラットパネルディスプレイ(FPT)用 加熱装置</p>	<p>液晶ディスプレイ製造用加熱装置MB・MSシリーズ、 液晶・OLEDディスプレイ製造用加熱装置MTシリーズ、 液晶ディスプレイ製造用ホットプレート式加熱装置、 液晶・OLEDディスプレイ製造用減圧乾燥装置、液晶用ウォーキングビーム式連続焼成炉</p>
<p>太陽電池関連装置</p>	<p>縦型ガラス基板加熱装置、薄膜太陽電池EVA架橋炉、縦型多段式拡散炉 ウォーキングビーム式連続乾燥炉</p>
<p>電子部品加熱装置</p>	<p>メッシュベルト搬送式連続炉(マッフル)、メッシュベルト搬送式連続炉(マッフルレス) ローラーハースキルン、電子部品用各種テスト炉</p>
<p>ヒーター及び関連機器</p>	<p>ラジアントパットヒーター(PD・GPDシリーズ) インフラユニ(BD・SGシリーズ) インフラユニットヒーター(PS・PU・PH・PMシリーズ) 各種ヒーター</p>
<p>自動車部品用加熱装置</p>	<p>自動車関連工業加熱装置(ハイテンション鋼板用)、金型加熱装置、金型予熱装置</p>



IGZO、OLEDアニール装置



各種ヒーター



自動車関連ハイテンション鋼板
ローラーハース式加熱炉 多段式加熱炉



5-7 クリーニング事業製品



ワイシャツプレス機	ワイシャツを熱板、熱風で仕上げる装置 襟・カフス部、タック・袖部、ボディ部を3台の装置で仕上げるタイプは、高速タイプで、ワイシャツプレス機の定番商品 タック・袖部と、ボディ部一体で仕上げる、ボディースリーブタイプもある
ウール仕上機	ジャケット、パンツなど仕上げる装置
自動包装機	クリーニング完了後の衣類を自動で包装する装置 ハンガーにかけたまま包装する立体タイプと、畳んだ状態で包装する平面タイプがある
アパレル関連機械	洋服の生産工程、縮絨機(生地を蒸気で安定化させる)、芯地・接着機(裁断後の生地を張り合わせる) プレス仕上げ機(完成商品のシワを取り成型する)等、各種装置をラインナップ



全自動包装機 (立体タイプ)



ワイシャツ用ボディースリーブプレス機



パンツ仕上機



ジャケット仕上機



さあ今日も、

ときめきと感動の日々であれ！

くまやか先端技術企業

 **ワイエイシー株式会社**

数字の処理について

記載されている金額は百万円未満を切り捨て、その比率については小数 第2位を四捨五入しています。

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予数値と異なる可能性があります。